

(2)

7. 如申請專利範圍第 1 項之塑膠組成物，其中，該防火劑佔該組成物之重量百分比為 20 至 40%，並且，該防火劑選擇由硼酸鋅、氫氧化鋁、氫氧化鎂及其任意混合所組成的群組其中之一種。
8. 如申請專利範圍第 1 項之塑膠組成物，其中，該偶合劑佔該組成物之重量百分比為 1 至 5%，該偶合劑選擇由矽甲烷、鈦酸鹽、鋁鎳酸鹽及其任意混合所組成的群組其中之一種，或選擇由順丁烯二酐和聚丙烯、乙丙三元橡膠、苯乙烯-乙炔-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物、苯乙烯-乙炔-丙烯-苯乙烯嵌段共聚物及其任意混合所組成的群組其中之一種。
9. 如申請專利範圍第 1 項之塑膠組成物，其中，該組成物的熱傳導係數至少大於 1.0Watts/m-K，熔融指數至少大於 0.5g/10min 以上，表面阻抗至少大於 $1E+9\Omega/sq$ ，熱變形溫度大於 105 以上，並且，該組成物具有阻燃等級 UL94 V1 以上。
10. 如申請專利範圍第 1 項之塑膠組成物，更包括一加工助劑，該加工助劑選擇由塑化劑、滑劑、抗氧化劑、UV 安定劑、熱安定劑、染料、顏料及其任意混合所組成的群組其中之一種。
11. 一種塑膠組成物，該組成物表面阻抗至少大於 $1E+9\Omega/sq$ ，且熱傳導係數大於 1W/m-K，包含：A.至少一種聚烯烴，佔該組成物之重量百分比為 5 至 45%；B.至少一種熱塑性彈性體，佔該組成物之重量百分比為 3 至 25%，其中，該聚烯烴與該熱塑性彈性體的總和佔該組成物之重量百分比為 10 至 50%；及 C.至少一種熱傳導性填充物，佔該組成物之重量百分比為 35 至 85%，其中，該熱傳導性填充物選自於金屬材料、熱傳導值大於 10Watts/m-K 的非金屬材料或其混合。
12. 一種如申請專利範圍第 1 或 11 項所述的塑膠組成物之加工方法，應用於散熱零組件及 LED 燈殼，選擇射出、押出或熱壓成型。